

芯原微电子（上海）股份有限公司

2024 年度“提质增效重回报”行动方案

芯原微电子（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）致力于提高上市公司质量，增强投资者回报，提升投资者的获得感。为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司及全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，公司制定 2024 年度“提质增效重回报”行动方案，切实履行上市公司的责任和义务，进一步提升公司经营效率，构建良好的资本市场形象，共同促进科创板市场平稳运行。

公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案主要措施如下：

一、聚焦主营业务，提升科技创新能力

公司是一家依托自主半导体 IP，为客户提供平台化、全方位、一站式芯片定制服务和半导体 IP 授权服务的企业。自 2001 年设立以来，公司始终深耕主营业务，作为全球领先的半导体 IP 授权服务提供商和芯片定制服务提供商，目前拥有包括图形处理器（GPU）IP、神经网络处理器（NPU）IP、视频处理器（VPU）IP、数字信号处理器（DSP）IP、图像信号处理器（ISP）IP、显示处理器 IP 六类处理器 IP，以及 1,500 多个数模混合 IP 和射频 IP，已成为中国大陆排名第一、全球排名第七的半导体 IP 供应商（IPnest, 2023 年）；在一站式芯片定制服务方面，芯原已拥有 14nm/10nm/7nm/5nm FinFET 和 28nm/22nm FD-SOI 工艺节点芯片的成功流片经验。基于公司先进的半导体 IP 技术和芯片定制技术，公司服务水平和质量受到诸多国内外知名客户的认可。

2024 年度，公司将继续聚焦主营业务，进一步提高公司半导体 IP 业务和一站式芯片定制业务的竞争优势和市场占有率，并根据短、中、长期发展战略进行有序的研发布局以实现稳步的可持续经营和未来的跨越式发展，推动公司业绩的持续增长。为达到上述目标，公司将从技术研发、人才培养、资源整合这几个方

面开展工作。具体的经营计划如下：

（一）技术研发

公司将持续推进核心技术的研发迭代，以保持技术先进性和核心竞争力，并始终关注市场趋势和技术发展动向，针对目标和关键市场，积极开展新技术的研发，进一步提升公司的科技创新能力和核心竞争力。

在半导体 IP 业务方面，持续升级现有半导体 IP 产品系列，包括公司核心的六类处理器 IP 以及丰富的数模混合 IP 和射频 IP；针对目标市场如智慧可穿戴、物联网无线通信、数据中心和汽车等应用的具体需求，进一步优化 IP 平台解决方案和整体解决方案，扩大 IP 技术价值和提升用户粘性；针对生成式 AI(AIGC)、边缘计算等快速发展的新兴市场，基于公司 NPU、GPU 和 DSP 等技术储备，持续打造创新的 AI 子系统解决方案，并结合公司多项技术能力，助力各产业人工智能升级发展。

在一站式芯片定制业务方面，持续优化基于先进生产工艺的芯片设计与验证方法；结合软件团队的优势，扩大系统平台解决方案如数据中心视频转码、可穿戴式健康监测、自动驾驶/汽车高级驾驶辅助系统等平台项目的产业化；继续推进 Chiplet 相关技术和项目的研发、设计实现与产业化；深化与大型互联网企业、云服务提供商等客户的合作，共同打造和完善按应用领域划分的系统生态等。

（二）人才培养

人才是公司发展的重要资源。随着公司临港研发中心的建成，公司上海研发布局将由张江高科技园区单研发中心布局扩张至张江及临港双研发中心布局，有助于公司招募到更多优秀的人才以保持公司技术先进性，加快技术人才体系建设并完善公司战略布局。公司将根据未来发展战略目标，通过优质的校园招聘和社会招聘，引进相关的优秀人才。公司将通过进一步优化人力资源管理体系，如强化企业文化，制定科学高效的培训制度等，来提升员工的企业归属感和加强公司的人才梯度建设。公司还将不断优化绩效管理体系、依托资本市场制定长效的股权激励计划，充分调动员工的积极性，为公司创造更多价值。

（三）资源整合

公司以芯片设计服务为主要业务，作为集成电路设计企业和制造企业之间的桥梁，在整个产业链中具有重要的沟通和衔接作用，因为对整个产业链的全局发展有着较为全面的认知。公司将充分利用这一优势，积极推进产业链上下游的合作，推动产业的生态建设，加强产业间的融合，提升公司的产业地位和整体竞争力。同时，公司还将继续依托平台化公司对产业发展趋势的理解，以及对特定标的未来发展潜力的预估，视业务需要择机进行与公司战略发展方向相一致的投资或并购。

二、优化运营效率

公司高度重视业务和市场发展绩效，将持续坚定拓展目标市场，履行国际化发展战略，深化与各领域头部企业的合作广度与深度，基于芯原的半导体 IP、芯片定制硬件、软件平台的技术赋能能力，持续提升芯原在相关领域中的地位与价值。同时，公司将积极响应国家号召，持续打造高质量的科技创新成果，以赋能新质生产力。通过将自身发展战略与产业发展趋势和方向深度匹配，进一步优化公司的业务布局和运营效率，逐步提升盈利质量。

此外，公司还将通过持续优化研发、存货、应收账款、资金等事项的运营管理，重点加强应收账款情况的实时监控、逾期催收等工作，进一步提高回款速度，提升公司经营效率以及资金效率。

三、稳步推动再融资项目

2023 年 12 月，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过 2023 年度向特定对象发行股票事项（以下简称“再融资”），拟向不超过 35 名符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者（QFII）、其它境内法人投资者和自然人等特定投资者募集不超过 180,815.69 万元（含本数），募集资金投资投向为 AIGC 及智慧出行领域 Chiplet 解决方案平台研发项目和面向 AIGC、图形处理等场景的新一代 IP 研发及产业化项目。本次募集资金投资项目紧紧围绕公司主营业务展开，是在公司现有业务与技术成果的基础上的升级与扩充，将为公司实现中长期战略发展目标奠定坚实的基础。

2024 年度，公司将结合市场情况稳步推进再融资项目。通过再融资募投项目的实施，公司将进一步丰富公司技术矩阵、提升产品性能、完善下游应用市场布局、探索前沿技术研究，以满足公司研发布局与业务扩张需求，持续强化公司的科创实力。

四、完善公司治理结构

（一）完善内部控制体系建设

公司将不断健全公司治理结构，优化业务流程，并结合法律法规的更新以及公司实际情况，全面梳理公司现有内部控制制度，不断对内控体系进行完善，明确相关部门人员的职责和权限，持续深入开展治理活动，提升公司治理水平，为公司股东合法权益的保护提供有力保障。

（二）加强募集资金管理

公司将严格执行《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件以及《芯原微电子（上海）股份有限公司章程》《芯原微电子（上海）股份有限公司募集资金管理办法》的规定，开设专户存储，严格管理募集资金使用，确保募集资金按照既定用途得到充分有效利用。公司、保荐机构、存管银行将持续对公司募集资金使用进行检查和监督，以保证募集资金合理规范使用，合理防范。

（三）董监高相关培训

公司将督促董监高积极参与上交所等监管机构举办的各种培训，加强学习证券市场相关法律法规，熟悉证券市场知识，推动公司持续规范运作。

五、加强与投资者的沟通

公司始终重视与广大投资者的交流互动，并致力于维护良好的投资者关系。公司将积极建立公开、公平、透明、多维度的投资者沟通渠道，通过业绩说明会、投资者邮箱、投资者专线、“上证 e 互动”平台等各种形式与投资者积极沟通，加深投资者对于公司经营情况的了解，增强投资者对公司的认同感，增进交流互

信，树立市场信心。

六、完善投资者回报机制

2023年12月，公司制定并披露了《未来三年（2023年-2025年）股东回报规划》，公司的利润分配着眼于公司的长远和可持续发展，在综合考虑公司未来战略发展目标的基础上，兼顾各类股东意愿，结合公司的盈利情况和现金流量状况、经营发展规划及企业所处的发展阶段、资金需求情况、社会资金成本以及外部融资环境等因素，依据《公司章程》的要求，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，并对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的合理性、连续性和稳定性。

公司将根据经营情况与发展规划，严格执行分红政策，在符合条件的情况下积极推动对广大股东的利润分配以及现金分红，强化对投资者的回报机制。

七、强化管理层与股东的利益共担共享约束并强化“关键少数”的责任

（一）强化股权激励及相关约束

科创板上市后，公司推出了2020年限制性股票激励计划及2022年限制性股票激励计划，通过实施上述股权激励计划，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，促进公司核心人才队伍的建设和稳定，从而有助于公司长远发展，维护股东权益。公司上述股权激励计划考核指标分为两个层面，分别为公司层面业绩考核、个人层面绩效考核。公司选取营业收入增长率作为公司层面业绩指标，营业收入增长率是衡量企业经营状况和市场占有能力，预测企业经营业务拓展趋势的重要标志，也是反映企业成长性的有效指标。除公司层面的业绩考核外，公司对所有激励对象个人设置了严密的绩效考核体系，能够对激励对象的工作绩效做出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象前一年度绩效考核结果，确定激励对象个人是否达到归属条件。

上述考核体系在具有良好的科学性和合理性的同时，也对激励对象具有约束

效果，能够实现股权激励的约束作用，有助于提升公司整体质量，增强投资者回报。

（二）管理层承诺不减持

基于对公司未来发展的信心以及对公司长期价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展，维护资本市场的稳定，切实保护全体股东利益，公司董事长兼总裁 Wayne Wei-Ming Dai（戴伟民）先生，董事、副总裁 Wei-Jin Dai（戴伟进）先生，董事、副总裁、首席财务官、董事会秘书施文茜女士，副总裁汪洋先生，副总裁汪志伟先生，副总裁 Martyn Humphries 先生自愿承诺自 2024 年 2 月 5 日起 6 个月内不减持上述其所持有的公司股份，包括承诺期间该部分股份因公司送红股、转增股本、配股等原因而增加的股份。

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于部分董事、高级管理人员自愿承诺不减持公司股份的公告》（公告编号：2024-006）。

八、其他措施

公司将持续对“提质增效重回报”行动方案的具体措施进行评估，并及时履行信息披露义务。未来，公司将进一步提升经营管理水平，继续深耕主营业务，强化核心竞争力，巩固市场地位，优化盈利结构；公司管理层也将一如既往地致力于提升公司业绩和市值，为股东创造更多的投资回报。

本报告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

芯原微电子（上海）股份有限公司董事会

2024 年 3 月 29 日